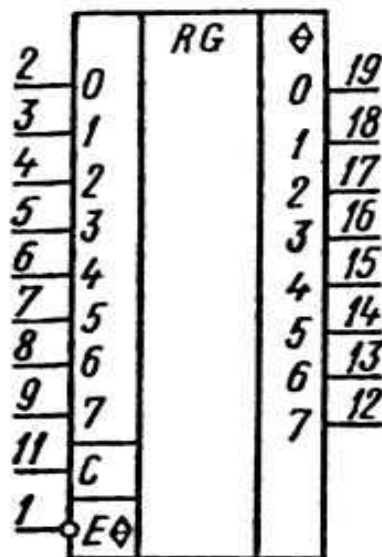


КР1533ИР33, КФ1533ИР33, ЭКР1533ИР33, ЭКФ1533ИР33

Микросхемы представляют собой восьмиразрядный буферный регистр. Применение выхода с тремя состояниями и увеличенная нагрузочная способность обеспечивает работу непосредственно на магистраль без дополнительных схем интерфейса. Содержат 414 интегральных элементов. Корпус типа 2140.20-8, масса не более 2,6 г, 4321.20-В, 2140.20-В.

Назначение выводов: 1 - вход разрешения снятия состояния высокого импеданса с выходом $\overline{E}\diamond$; 2 - вход информационный D0; 3 - вход информационный D1; 4 - вход информационный D2; 5 - вход информационный D3; 6 - вход информационный D4; 7 - вход информационный D5; 8 - вход информационный D6; 9 - вход информационный D7; 10 - общий; 11 - вход стробирования C; 12 - выход Q7; 13 - выход Q6; 14 - выход Q5; 15 - выход Q4; 16 - выход Q3; 17 - выход Q2; 18 - выход Q1; 19 - выход Q0; 20 - напряжение питания.



Условное графическое обозначение КР1533ИР33, КФ1533ИР33, ЭКР1533ИР33, ЭКФ1533ИР33

Таблица истинности

Вход			Выход
$\overline{E}\diamond$	C	D	Q
0	1	1	1
0	1	0	0
0	0	X	Q0
1	X	X	\diamond

Примечание. X - безразличное состояние; \diamond - состояние высокого импеданса; Q0 - предыдущее состояние.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	5 В ± 10%
Выходное напряжение низкого уровня:	
- при $I_{\text{вых}}^0 = 12$ мА	≤ 0,4 В
- при $I_{\text{вых}}^0 = 24$ мА	≤ 0,5 В
Выходное напряжение высокого уровня	
- при $I_{\text{вых}}^1 = -2,6$ мА	≥ 2,4 В
- при $I_{\text{вых}}^1 = -0,4$ мА	≥ 2,5 В
Прямое падение напряжения на антизвонном диоде	≤ -1,5 В
Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения, при $U_{\text{п}} = 5,5$ В	≤ 17 мА
Ток потребления при низком уровне выходного напряжения, при $U_{\text{п}} = 5,5$ В	≤ 24 мА
Ток потребления в состоянии «выключено» при $U_{\text{п}} = 5,5$ В	≤ 27 мА
Входной ток низкого уровня	≤ -0,1 мА
Входной ток высокого уровня	≤ 20 мкА
Входной пробивной ток	≤ 0,1 мА
Выходной ток высокого уровня в состоянии «выключено»	≤ 20 мкА
Выходной ток низкого уровня в состоянии «выключено»	≤ -20 мкА
Выходной ток	-15 ... -70 мА
Время задержки распространения сигнала при включении:	
- по входам D	≤ 14 нс
- по входам E	≤ 19 нс
Время задержки распространения сигнала при выключении:	
- по входам D	≤ 14 нс
- по входам E	≤ 20 нс
Время задержки распространения при переходе из состояния низкого уровня в состояние «выключено» (при уровне отсчета на выходном напряжении 0,7 В)	≤ 15 нс
Время задержки распространения при переходе из состояния «выключено» в состояние низкого (высокого) уровня	≤ 18 нс
Время задержки распространения при переходе из состояния высокого уровня состояние «выключено» (при уровне отсчета на выходном напряжении 2,1 В)	≤ 30 нс
Емкость входа	≤ 5 пФ
Емкость выхода	≤ 7 пФ

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение питания	4,5...5,5 В
Входное напряжение низкого уровня	0...0,8 В
Входное напряжение высокого уровня	2...5,5 В
Максимальное напряжение, подаваемое на выход	5,5 В
Температура окружающей среды	-10...+70 °С

Общие рекомендации по применению

Безотказность работы микросхем в аппаратуре достигается: правильным выбором условий эксплуатации и электрических режимов микросхем; соблюдением последовательности монтажа микросхем в аппаратуре, исключающих тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Лужение производить в следующих режимах: температура расплавленного припоя не более 260 °С; время погружения не более 2 с; расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм; допустимое количество погружений не более 2; интервал между двумя погружениями не менее 5 мин.

Лужение и пайка должны производиться предпочтительно припоем ПОС61 по ГОСТ 21930-76, флюсом, состоящим из 25% по массе канифоли и 75% по массе изопропилового или этилового спирта.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Пайку микросхем на печатную плату одножальным паяльником производить по следующему режиму: температура жала паяльника не более 270 °С; время касания каждого вывода не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Жало паяльника должно быть заземлено.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более 265 °С; время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее 5 мин.

Операцию очистки печатных плат с микросхемами от паяльных флюсов производить тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1, ацетоном, спиртом или трихлорэтиленом, исключив при этом механическое повреждение выводов.

Сушку печатных плат с микросхемами после очистки производить при температуре не выше 60 °С.

Для влагозащиты плат с микросхемами применять лак УР-231 по

ТУ 6-10-863-84 или ЭП-730 по ГОСТ 20924-81. Оптимальная толщина покрытия лаком УР231 должна быть 35...55 мкм, лаком ЭП-730 - 35...100 мкм.

Количество слоев 3.

Рекомендуемая температура сушки (полимеризации) лака 65 ± 5 °С.

Свободные входы необходимо подключать к источнику постоянного напряжения $5 \text{ В} \pm 10\%$, к источнику выходного напряжения высокого уровня или заземлять.

Допустимое значение электростатического потенциала 200 В.